



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H700-Soft 超软系列

【导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

应用特点：

- 低压力应用、可压缩性好
- 无回弹应力或低回弹应力
- 低热阻
- 良好的界面接触
- 良好的绝缘性、耐高压击穿

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 家电行业
- 可穿戴设备
- 装配压力敏感环境

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

运输过程及产品室温储存条件：阴暗处储存

储存温度：20±5℃

储存湿度：40%~70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：产品最佳使用期限是产品出厂的2周内，最终使用期限不超过1个月；

注意事项：

使用时戴好手套，避免粘性面与手上的汗液接触，使粘性面粘性减少；且轻拿轻放，避免损坏产品表面。

产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	灰白色	---	目视
厚 度	1~4	mm	ASTM D 374
硬 度	40±5	Shore 00	ASTM D 2240
密 度	3.2±0.2	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥0.05	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	≥40	%	ASTM D 412
压 缩 比	≥50 (@50Psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-50~180	℃	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	7.0±0.7	W/m·K	ASTM D 5470
@15Psi/2mm	0.28	°Cin²/W	ASTM D 5470
@30Psi/2mm	0.22	°Cin²/W	ASTM D 5470
@50Psi/2mm	0.15	°Cin²/W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ⁸	Ω·cm	ASTM D 257

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权